

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-017

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司2023年度审计报告》，截止2023年12月31日，公司经审计的实收股本为28,080.43万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34万元，未弥补亏损金额为13,161.34万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、截至2023年12月31日，公司累计亏损金额-13,161.34万元；

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-16,235.24万元，亏损额较2022年度有所增加，主要原因为：

（1）全球经济整体复苏态势不及预期，地缘政治冲突仍在产生持续且较强的负面冲击，导致公司所在行业竞争更显激烈，产品价格进一步下降。报告期内，公司电子元器件产品销售收入36,410.00万元，销售量105,017万只，销售量较上年同期增长了40.96%；产品均价约0.35元，较上年同期下降了28.23%。

（2）公司整体产能仍未能充分释放与消化。报告期内，公司电子元器件产量为99699万只，较上年同期增长22.55%，但与公司超20亿只的整体产能相比仍有差距。

（3）期末存货、应收账款仍处于较高水平，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，计提各项减值准备7,877.93万元，较上年同期增加2,236.54万元。

三、应对措施

1、深耕主营业务，提升核心竞争力

公司主要产品为 SMD 谐振器、TSX 热敏晶体、TCXO 振荡器、OSC 振荡器，在国内具备量产优势。随着新兴技术的发展，如物联网、5G 通信、人工智能和自动驾驶等，对晶振在小尺寸、高频率、低功耗等方面提出了更高的要求。公司将继续深耕附加值较高的高基频、小型化 SMD 谐振器及 TCXO 振荡器、TSX 热敏晶体等产品，不断完善产品种类、提升产品质量，以满足客户的不同需求。

2、优化体系建设，提升管理效率

公司将持续加强现代企业规范化管理体系建设，深入推进 6S 精益化生产管理。与此同时，不断完善公司内部控制建设，从采购、营销、生产、财务、IT、人力资源等环节为抓手，优化操作流程，提高企业运营效率。

3、紧跟市场需求，逐步去化产能

公司 2024 年将以改善生产经营为主要目标，密切关注市场动态，合理优化经营策略，优化资源配置，实现产能去化，努力提升经营业绩。客户方面，紧跟客户尤其是大客户的需求，致力于为客户提供更加满意的解决方案；市场方面，在巩固原有市场的基础之上，努力寻求新兴业务市场的机会；人员管理方面，完善利益共享机制，进一步增强核心经营管理团队、营销团队与公司共同发展的价值理念。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日